



\*a Leiterplattenlayout  
 printed circuit board layout  
 modèle de la carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>2411 01</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Verpackung: im Tablett  
 Packaging: in tray  
 Emballage: en tableau

### 2411 01

USB-2.0-Einbauplugung Typ B, stehende Ausführung, für Leiterplatten

#### 1. Werkstoffe

Kontaktträger	PBT GF
Kontaktfeder	CuZn, unternickelt und vergoldet
Lötanschluss	CuZn, unternickelt und verzinkt
Gehäuse	CuZn, unternickelt und verzinkt

#### 2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	USB-Stecker 2431
-------------------	------------------

#### 3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

### 2411 01

USB 2.0 chassis socket type B, upright version, for printed circuit boards

#### 1. Materials

Body	PBT GF
Contact spring	CuZn, pre-nickel and gilded
Solder pin	CuZn, pre-nickel and tinned
Shell	CuZn, pre-nickel and tinned

#### 2. Mechanical data

Mating with	USB plug 2431
-------------	---------------

#### 3. Electrical data

Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

### 2411 01

Embase femelle USB 2.0 type B, version droite, pour cartes imprimées

#### 1. Matériaux

Corps isolant	PBT GF
Ressort de contact	CuZn, sous-nickelé et doré
Plot à souder	CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier	CuZn, sous-nickelé et étamé

#### 2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteur mâle USB 2431
-------------------	--------------------------

#### 3. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ